

产品介绍

PGT-100导热硅胶垫片具有低应力,优良的绝缘性、可压缩性、表面天然的粘性,能够充填缝隙,完成发热部位间的热传递,减震等作用;能够满足设备小型化和超薄化的设计要求,具有工艺性和使用性,且厚度适用范围广,是一种极佳的导热填充材料,广泛应用于电子电器产品中。

产品特点

- 低应力,可压缩
- 优异的导热速率
- 耐高压,高绝缘,抗震,抗冷热变化
- 阻燃达 UL94 V-0

主要用途

- 手机,电脑,通讯模块,TV
- WIFI 模块,路由器,传感器
- 大功率电器,LED 灯
- 快充头,光伏逆变器,智能家电
- 动力电池模组,连接器,变压器,需绝缘和散热部件等

环保要求

- 该系列产品符合 RoHS, 卤素管控标准

储存方式

- 储存条件:阴暗处储存;
储存温度: $\leq 30^{\circ}\text{C}$;
储存湿度: $\leq 70\%$;
- 保质期:在储存条件下两年。

成分及构成

- 导热填料
- 聚硅氧烷弹性体

产品规格

- 长宽尺寸: 200mm×400mm ,可依客户要求定制
- 产品厚度:0.3~10mm,可满足不同应用需求

技术参数

| 测试项目 | 技术指标 |
|--|-------------------|
| 厚度 mm 参考 ASTM D374 | 0.3-10mm |
| 颜色 目视 | 浅灰色 |
| 硬度 shore 00 参考 ASTM D2240 | 45±15 |
| 导热系数 W/(m·K) 参考 ASTM D5470 | 1.0±0.2 |
| 密度 g/cm ³ 参考 ASTM D792 | 2.2±0.5 |
| 阻燃等级 UL 94 | V0 |
| 介电强度 KV/mm 参考 ASTM D149 | ≥6 |
| 体积电阻率 $\Omega\cdot\text{cm}$ 参考 ASTM D257 | ≥10 ¹⁰ |
| 适用温度 $^{\circ}\text{C}$ 参考 EM344 | -40~200 |

以上是在 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $50\pm 5\%\text{RH}$ 下的检测数据;环境温度湿度的不同,测试值会有所差异。

该资料中所包含的真实可靠的数据信息旨在协助您采用广迈导热硅胶材料进行的设计,基于我们目前的认知和经验确定的产品应用范围,无意且不构成任何明示的或隐含的担保,包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保,亦不保证用户可在特定用途中达到本资料中显示的结果。对于范围之外的应用,或者是不同条件和环境下的使用,产生的结果广迈将不负任何责任。因此我们强烈建议用户在使用之前应确定广迈导热硅胶材料的适用性。